

E DIN EN ISO/IEC 15408-3:2024-03 (D/E)

Erscheinungsdatum: 2024-02-16

Informationssicherheit, Cybersicherheit und Schutz der Privatsphäre -
Evaluationskriterien für IT-Sicherheit - Teil 3: Sicherheit
Gewährleistungskomponenten (ISO/IEC 15408-3:2022); Deutsche und Englische
Fassung EN ISO/IEC 15408-3:2023

Information security, cybersecurity and privacy protection - Evaluation criteria for IT
security - Part 3: Security assurance components (ISO/IEC 15408-3:2022); German
and English version EN ISO/IEC 15408-3:2023

Inhalt	Seite
Europäisches Vorwort.....	14
Vorwort.....	15
Einleitung.....	17
1 Anwendungsbereich.....	18
2 Normative Verweisungen.....	18
3 Begriffe.....	18
4 Übersicht.....	23
5 Paradigma für Vertrauenswürdigkeit.....	24
5.1 Allgemeines.....	24
5.2 Ansatz der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	24
5.3 Ansatz für Vertrauenswürdigkeit.....	24
5.3.1 Allgemeines.....	24
5.3.2 Bedeutung von Anfälligkeiten.....	24
5.3.3 Ursachen von Anfälligkeiten.....	25
5.3.4 Vertrauenswürdigkeit der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	25
5.3.5 Vertrauenswürdigkeit durch Evaluierung.....	25
5.4 Vertrauenswürdigkeitsskala der Normenreihe ISO/IEC 15408.....	26
6 Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	26
6.1 Allgemeines.....	26
6.2 Struktur der Vertrauenswürdigkeitsklassen.....	27
6.2.1 Allgemeines.....	27
6.2.2 Klassenname.....	27
6.2.3 Klasseneinleitung.....	27
6.2.4 Vertrauenswürdigkeitsfamilien.....	27
6.3 Struktur der Vertrauenswürdigkeitsfamilien.....	28
6.3.1 Familienname.....	28
6.3.2 Ziele.....	28
6.3.3 Komponentenebenen.....	29
6.3.4 Anwendungshinweise.....	29
6.3.5 Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	29
6.4 Struktur der Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....	29
6.4.1 Allgemeines.....	29
6.4.2 Komponentenidentifikation.....	30
6.4.3 Ziele.....	30
6.4.4 Anwendungshinweise.....	30
6.4.5 Abhängigkeiten.....	30
6.4.6 Vertrauenswürdigkeitselemente.....	30

6.5	Vertrauenswürdigkeitselemente.....	31
6.6	Komponententaxonomie.....	31
7	Klasse APE: Evaluierung des Schutzprofils (PP)	32
7.1	Allgemeines.....	32
7.2	PP-Einleitung (APE_INT)	32
7.2.1	Ziele	32
7.2.2	APE_INT.1 PP-Einleitung.....	32
7.3	Konformitätsansprüche (APE_CCL).....	33
7.3.1	Ziele	33
7.3.2	APE_CCL.1 Konformitätsansprüche.....	33
7.4	Sicherheitsproblemdefinition (APE_SPD).....	36
7.4.1	Ziele	36
7.4.2	APE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition.....	36
7.5	Sicherheitszielsetzungen (APE_OBJ).....	37
7.5.1	Ziele	37
7.5.2	Komponentenebenen	37
7.5.3	APE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen für die Betriebsumgebung.....	37
7.5.4	APE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen.....	38
7.6	Erweiterte Komponentendefinition (APE_ECD).....	39
7.6.1	Ziele	39
7.6.2	APE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition.....	39
7.7	Sicherheitsanforderungen (APE_REQ).....	40
7.7.1	Ziele	40
7.7.2	Komponentenebenen	40
7.7.3	APE_REQ.1 Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls mit direkter Begründung.....	40
7.7.4	APE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen.....	41
8	Klasse ACE: Evaluierung der Schutzprofilkonfiguration	43
8.1	Allgemeines.....	43
8.2	Einleitung für PP-Module (ACE_INT).....	44
8.2.1	Ziele	44
8.2.2	ACE_INT.1 Einleitung für PP-Module.....	44
8.3	Konformitätsansprüche des PP-Moduls (ACE_CCL)	45
8.3.1	Ziele	45
8.3.2	ACE_CCL.1 Konformitätsansprüche des PP-Moduls	45
8.4	Sicherheitsproblemdefinition des PP-Moduls (ACE_SPD)	47
8.4.1	Ziele	47
8.4.2	ACE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition des PP-Moduls	47
8.5	Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls (ACE_OBJ)	48
8.5.1	Ziele	48
8.5.2	Komponentenebenen	48
8.5.3	ACE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls für die Betriebsumgebung.....	48
8.5.4	ACE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen des PP-Moduls	49
8.6	Erweiterte Komponentendefinition des PP-Moduls (ACE_ECD)	50
8.6.1	Ziele	50
8.6.2	ACE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition des PP-Moduls	50
8.7	Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls (ACE_REQ).....	51
8.7.1	Ziele	51
8.7.2	Komponentenebenen	51
8.7.3	ACE_REQ.1 Festgelegte Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls	51
8.7.4	ACE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen des PP-Moduls	53
8.8	Konsistenz des PP-Moduls (ACE_MCO).....	54
8.8.1	Ziele	54
8.8.2	ACE_MCO.1 Konsistenz des PP-Moduls.....	54
8.9	Konsistenz der PP-Konfiguration (ACE_CCO).....	56
8.9.1	Ziele	56
8.9.2	ACE_CCO.1 Konsistenz der PP-Konfiguration.....	56

9	Klasse ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST)	60
9.1	Allgemeines	60
9.2	ST-Einleitung (ASE_INT)	60
9.2.1	Ziele	60
9.2.2	ASE_INT.1 ST-Einleitung	60
9.3	Konformitätsansprüche (ASE_CCL)	62
9.3.1	Ziele	62
9.3.2	ASE_CCL.1 Konformitätsansprüche	62
9.4	Sicherheitsproblemdefinition (ASE_SPD)	64
9.4.1	Ziele	64
9.4.2	ASE_SPD.1 Sicherheitsproblemdefinition	64
9.5	Sicherheitszielsetzungen (ASE_OBJ)	65
9.5.1	Ziele	65
9.5.2	Komponentenebenen	65
9.5.3	ASE_OBJ.1 Sicherheitszielsetzungen für die Betriebsumgebung	65
9.5.4	ASE_OBJ.2 Sicherheitszielsetzungen	66
9.6	Erweiterte Komponentendefinition (ASE_ECD)	67
9.6.1	Ziele	67
9.6.2	ASE_ECD.1 Erweiterte Komponentendefinition	67
9.7	Sicherheitsanforderungen (ASE_REQ)	68
9.7.1	Ziele	68
9.7.2	Komponentenebenen	68
9.7.3	ASE_REQ.1 Direkte Begründung für die Sicherheitsanforderungen	68
9.7.4	ASE_REQ.2 Abgeleitete Sicherheitsanforderungen	70
9.8	Zusammenfassende Spezifikation des TOE (ASE_TSS)	71
9.8.1	Ziele	71
9.8.2	Komponentenebenen	72
9.8.3	ASE_TSS.1 Zusammenfassende Spezifikation des TOE	72
9.8.4	ASE_TSS.2 Zusammenfassende Spezifikation des TOE mit zusammenfassendem Architekturdesign	72
9.9	Konsistenz der Sicherheitsvorgaben des Verbundprodukts (ASE_COMP)	73
9.9.1	Ziele	73
9.9.2	Komponentenebenen	73
9.9.3	Anwendungshinweise	73
9.9.4	ASE_COMP.1 Konsistenz der Sicherheitsvorgabe (ST)	75
10	Klasse ADV: Entwicklung	76
10.1	Allgemeines	76
10.2	Sicherheitsarchitektur (ADV_ARC)	81
10.2.1	Ziele	81
10.2.2	Komponentenebenen	81
10.2.3	Anwendungshinweise	81
10.2.4	ADV_ARC.1 Beschreibung der Sicherheitsarchitektur	82
10.3	Funktionsspezifikation (ADV_FSP)	83
10.3.1	Ziele	83
10.3.2	Komponentenebenen	83
10.3.3	Anwendungshinweise	83
10.3.4	ADV_FSP.1 Grundlegende Funktionsanforderungen	86
10.3.5	ADV_FSP.2 Sicherheit durchsetzende Funktionsspezifikation	87
10.3.6	ADV_FSP.3 Funktionsspezifikation mit vollständiger Zusammenfassung	88
10.3.7	ADV_FSP.4 Vollständige Funktionsspezifikation	89
10.3.8	ADV_FSP.5 Vollständige semiformale Funktionsspezifikation mit zusätzlichen Fehlerinformationen	90
10.3.9	ADV_FSP.6 Vollständige semiformale Funktionsspezifikation mit zusätzlicher formaler Spezifikation	91
10.4	Darstellung der Implementierung (ADV_IMP)	93
10.4.1	Ziele	93
10.4.2	Komponentenebenen	93

10.4.3	Anwendungshinweise.....	93
10.4.4	ADV_IMP.1 Darstellung der Implementierung der TSF	94
10.4.5	ADV_IMP.2 Vollständige Zuordnung der Darstellung der Implementierung der TSF.....	95
10.5	TSF-Interna (ADV_INT).....	96
10.5.1	Ziele	96
10.5.2	Komponentenebenen	96
10.5.3	Anwendungshinweise.....	96
10.5.4	ADV_INT.1 Wohlstrukturierte Teilmengen von TSF-Interna.....	97
10.5.5	ADV_INT.2 Wohlstrukturierte Interna	98
10.5.6	ADV_INT.3 Minimal komplexe Interna.....	99
10.6	Modellierung der Sicherheitspolitik (ADV_SPM).....	100
10.6.1	Ziele	100
10.6.2	Komponentenebenen	100
10.6.3	Anwendungshinweise.....	100
10.6.4	ADV_SPM.1 Formales TOE-Sicherheitspolitikmodell	101
10.7	TOE-Design (ADV_TDS).....	103
10.7.1	Ziele	103
10.7.2	Komponentenebenen	103
10.7.3	Anwendungshinweise.....	103
10.7.4	ADV_TDS.1 Grundsätzliches Design	105
10.7.5	ADV_TDS.2 Architekturdesign	106
10.7.6	ADV_TDS.3 Grundsätzliches modulares Design	107
10.7.7	ADV_TDS.4 Semiformales modulares Design	108
10.7.8	ADV_TDS.5 Vollständiges semiformales modulares Design.....	110
10.7.9	ADV_TDS.6 Vollständiges semiformales modulares Design mit formaler allgemeiner Designarstellung.....	111
10.8	Compliance mit dem Verbunddesign (ADV_COMP).....	113
10.8.1	Ziele	113
10.8.2	Komponentenebenen	113
10.8.3	Anwendungshinweise.....	113
10.8.4	ADV_COMP.1 Design-Compliance mit den basiskomponentenbezogenen Leitlinien für Benutzer, dem ETR für Verbundevaluierung und dem Bericht der Evaluierungsinstanz der Basiskomponente.....	114
11	Klasse AGD: Leitliniendokumente	114
11.1	Allgemeines.....	114
11.2	Operative Leitlinien für Benutzer (AGD_OPE)	115
11.2.1	Ziele	115
11.2.2	Komponentenebenen	115
11.2.3	Anwendungshinweise.....	115
11.2.4	AGD_OPE.1 Operative Leitlinien für Benutzer	116
11.3	Vorbereitende Verfahren (AGD_PRE).....	117
11.3.1	Ziele	117
11.3.2	Komponentenebenen	117
11.3.3	Anwendungshinweise.....	117
11.3.4	AGD_PRE.1 Vorbereitende Verfahren.....	118
12	Klasse ALC: Unterstützung des Lebenszyklus	118
12.1	Allgemeines.....	118
12.2	CM-Funktionen (ALC_CMC).....	120
12.2.1	Ziele	120
12.2.2	Komponentenebenen	120
12.2.3	Anwendungshinweise.....	121
12.2.4	ALC_CMC.1 Kennzeichnung des TOE.....	121
12.2.5	ALC_CMC.2 Verwendung des CM-Systems.....	122
12.2.6	ALC_CMC.3 Autorisierungskontrollen	123
12.2.7	ALC_CMC.4 Herstellungsunterstützung, Abnahmeverfahren und Automatisierung.....	125
12.2.8	ALC_CMC.5 Erweiterte Unterstützung	128
12.3	CM-Umfang (ALC_CMS)	132

12.3.1	Ziele	132
12.3.2	Komponentenebenen.....	132
12.3.3	Anwendungshinweise.....	132
12.3.4	ALC_CMS.1 CM-Abdeckung des TOE.....	132
12.3.5	ALC_CMS.2 CM-Abdeckung für Teile des TOE	133
12.3.6	ALC_CMS.3 CM-Abdeckung für die Darstellung der Implementierung.....	134
12.3.7	ALC_CMS.4 CM-Abdeckung für die Problemverfolgung.....	135
12.3.8	ALC_CMS.5 CM-Abdeckung für Entwicklungswerkzeuge	136
12.4	Lieferung (ALC_DEL).....	137
12.4.1	Ziele	137
12.4.2	Komponentenebenen.....	137
12.4.3	Anwendungshinweise.....	137
12.4.4	ALC_DEL.1 Lieferverfahren	138
12.5	Sicherheit in der Entwicklungsumgebung (ALC_DVS).....	138
12.5.1	Ziele	138
12.5.2	Komponentenebenen.....	138
12.5.3	Anwendungshinweise.....	138
12.5.4	ALC_DVS.1 Identifikation von Sicherheitsmaßnahmen	139
12.5.5	ALC_DVS.2 Angemessenheit von Sicherheitsmaßnahmen	139
12.6	Mängelbeseitigung (ALC_FLR).....	140
12.6.1	Ziele	140
12.6.2	Komponentenebenen.....	140
12.6.3	Anwendungshinweise.....	140
12.6.4	ALC_FLR.1 Grundlegende Mängelbeseitigung.....	141
12.6.5	ALC_FLR.2 Verfahren zu Mängelberichten	142
12.6.6	ALC_FLR.3 Systematische Mängelbeseitigung.....	143
12.7	Entwicklung des Lebenszyklus (ALC_LCD).....	145
12.7.1	Ziele	145
12.7.2	Komponentenebenen.....	145
12.7.3	Anwendungshinweise.....	145
12.7.4	ALC_LCD.1 Vom Entwickler definierte Lebenszyklusprozesse.....	146
12.7.5	ALC_LCD.2 Messbares Lebenszyklusmodell.....	147
12.8	Artefakte der TOE-Entwicklung (ALC_TDA).....	148
12.8.1	Ziele	148
12.8.2	Komponentenebenen.....	148
12.8.3	Anwendungshinweise.....	149
12.8.4	ALC_TDA.1 Eindeutig identifizierende Implementierungsrepräsentation	149
12.8.5	ALC_TDA.2 Abgleich des Umfangs der Darstellung der Implementierung mit dem CMS.....	151
12.8.6	ALC_TDA.3 Neugenerierung des TOE mit genau definierten Entwicklungswerkzeugen	154
12.9	Werkzeuge und Techniken (ALC_TAT).....	157
12.9.1	Ziele	157
12.9.2	Komponentenebenen.....	157
12.9.3	Anwendungshinweise.....	158
12.9.4	ALC_TAT.1 Genau festgelegte Entwicklungswerkzeuge.....	158
12.9.5	ALC_TAT.2 Konformität mit Implementierungsstandards	159
12.9.6	ALC_TAT.3 Konformität mit Implementierungsstandards - alle Teile	160
12.10	Integration von Zusammensetzungsteilen und Konsistenzprüfung von Lieferverfahren (ALC_COMP).....	161
12.10.1	Ziele	161
12.10.2	Komponentenebenen.....	161
12.10.3	Anwendungshinweise.....	161
12.10.4	ALC_COMP.1 Integration der abhängigen Komponente in die zugehörige Basiskomponente und Konsistenzprüfung für Auslieferungs- und Abnahmeverfahren.....	161
13	Klasse ATE: Prüfungen.....	162
13.1	Allgemeines.....	162
13.2	Abdeckung (ATE_COV)	163
13.2.1	Ziele	163

13.2.2	Komponentenebenen	163
13.2.3	Anwendungshinweise.....	163
13.2.4	ATE_COV.1 Nachweis der Abdeckung	163
13.2.5	ATE_COV.2 Analyse der Abdeckung.....	164
13.2.6	ATE_COV.3 Strenge Analyse der Abdeckung.....	165
13.3	Tiefe (ATE_DPT).....	166
13.3.1	Ziele	166
13.3.2	Komponentenebenen	166
13.3.3	Anwendungshinweise.....	166
13.3.4	ATE_DPT.1 Prüfung: grundlegendes Design.....	166
13.3.5	ATE_DPT.2 Prüfung: Sicherheit-durchsetzende Module	167
13.3.6	ATE_DPT.3 Prüfung: modulares Design	168
13.3.7	ATE_DPT.4 Prüfung: Darstellung der Implementierung	169
13.4	Funktionsprüfungen (ATE_FUN)	170
13.4.1	Ziele	170
13.4.2	Komponentenebenen	170
13.4.3	Anwendungshinweise.....	170
13.4.4	ATE_FUN.1 Funktionsprüfung.....	170
13.4.5	ATE_FUN.2 Geordnete Funktionsprüfungen.....	171
13.5	Unabhängiges Prüfen (ATE_IND).....	172
13.5.1	Ziele	172
13.5.2	Komponentenebenen	172
13.5.3	Anwendungshinweise.....	173
13.5.4	ATE_IND.1 Unabhängige Prüfungen - Konformität.....	173
13.5.5	ATE_IND.2 Unabhängige Prüfungen - Stichprobe.....	174
13.5.6	ATE_IND.3 Unabhängige Prüfungen - vollständig	175
13.6	Prüfung von Verbundprodukten (ATE_COMP)	177
13.6.1	Ziele	177
13.6.2	Komponentenebenen	177
13.6.3	Anwendungshinweise.....	177
13.6.4	ATE_COMP.1 Funktionsprüfung des Verbundprodukts.....	178
14	Klasse AVA: Anfälligkeitsbewertung.....	178
14.1	Allgemeines.....	178
14.2	Anwendungshinweise.....	179
14.3	Anfälligkeitsanalyse (AVA_VAN)	179
14.3.1	Ziele	179
14.3.2	Komponentenebenen	179
14.3.3	AVA_VAN.1 Anfälligkeitsuntersuchung.....	180
14.3.4	AVA_VAN.2 Anfälligkeitsanalyse	180
14.3.5	AVA_VAN.3 Konzentrierte Anfälligkeitsanalyse.....	182
14.3.6	AVA_VAN.4 Methodische Anfälligkeitsanalyse	183
14.3.7	AVA_VAN.5 Erweiterte methodische Anfälligkeitsanalyse	184
14.4	Anfälligkeitsbewertung für Verbundprodukte (AVA_COMP)	186
14.4.1	Ziele	186
14.4.2	Komponentenebenen	186
14.4.3	Anwendungshinweise.....	186
14.4.4	AVA_COMP.1 Anfälligkeitsbewertung für Verbundprodukte	187
15	Klasse ACO: Zusammensetzung.....	187
15.1	Allgemeines.....	187
15.2	Begründung der Zusammensetzung (ACO_COR).....	190
15.2.1	Ziele	190
15.2.2	Komponentenebenen	190
15.2.3	ACO_COR.1 Begründung der Zusammensetzung.....	190
15.3	Entwicklungsnachweis (ACO_DEV).....	191
15.3.1	Ziele	191
15.3.2	Komponentenebenen	191
15.3.3	Anwendungshinweise.....	191

15.3.4	ACO_DEV.1 Funktionsbeschreibung.....	192
15.3.5	ACO_DEV.2 Einfacher Nachweis des Designs	193
15.3.6	ACO_DEV.3 Detaillierter Nachweis des Designs.....	194
15.4	Verlässlichkeit der abhängigen Komponente (ACO_REL)	195
15.4.1	Ziele	195
15.4.2	Komponentenebenen.....	195
15.4.3	Anwendungshinweise	195
15.4.4	ACO_REL.1 Einfache Verlässlichkeitsinformation	195
15.4.5	ACO_REL.2 Verlässlichkeitsinformationen	196
15.5	Prüfen des zusammengesetzten TOEs (ACO_CTT).....	197
15.5.1	Ziele	197
15.5.2	Komponentenebenen.....	197
15.5.3	Anwendungshinweise	197
15.5.4	ACO_CTT.1 Schnittstellenprüfung	198
15.5.5	ACO_CTT.2 Strenge Schnittstellenprüfung	199
15.6	Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung (ACO_VUL).....	200
15.6.1	Ziele	200
15.6.2	Komponentenebenen.....	201
15.6.3	Anwendungshinweise	201
15.6.4	ACO_VUL.1 Anfälligkeitsüberprüfung der Zusammensetzung	201
15.6.5	ACO_VUL.2 Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung.....	202
15.6.6	ACO_VUL.3 Erweitert-einfache Anfälligkeitsanalyse der Zusammensetzung.....	203
Anhang A (informativ) Entwicklung (ADV)		205
A.1	Ergänzende Informationen zu ADV_ARC: Sicherheitsarchitekturen	205
A.1.1	Allgemeines	205
A.1.2	Sicherheitsarchitektureigenschaften	205
A.1.3	Sicherheitsarchitekturbeschreibungen.....	206
A.2	ADV_FSP: Ergänzende Informationen zur Funktionsspezifikation	209
A.2.1	Allgemeines	209
A.2.2	Nicht-TSF-Teil des TOE	209
A.2.3	Bestimmen der TSFI	210
A.2.4	Beispiel: Ein komplexes DBMS.....	213
A.2.5	Beispiel-Funktionsspezifikation	214
A.3	ADV_INT: Ergänzende Informationen zu TSF-Interna	217
A.3.1	Allgemeines	217
A.3.2	Struktur von prozeduraler Software	217
A.3.3	Komplexität von prozeduraler Software	219
A.4	ADV_TDS: Teilsysteme und Module.....	219
A.4.1	Allgemeines	219
A.4.2	Teilsysteme	220
A.4.3	Module	221
A.4.4	Ansatz zur Einstufung	223
A.4.5	Sicherheitsrelevanz	225
A.5	Ergänzende Informationen zu formalen Methoden.....	226
Anhang B (informativ) Zusammensetzung (ACO)		228
B.1	Allgemeines	228
B.2	Notwendigkeit für Evaluierungen zusammengesetzter TOEs	228
B.3	Durchführung der Evaluierung von Sicherheitsvorgaben (ST) für einen zusammengesetzten TOE.....	230
B.4	Interaktionen zwischen zusammengesetzten IT-Entitäten.....	230
Anhang C (informativ) Querverweisung von Abhängigkeiten der Vertrauenswürdigkeitskomponenten.....		236
Literaturhinweise		242

Bilder

Bild 1 — Hierarchie von Vertrauenswürdigkeitsklasse/-familie/-komponente/-element	28
Bild 2 — Struktur der Vertrauenswürdigkeitskomponenten	29
Bild 3 — Muster eines Klassenaufbaudiagramms.....	32
Bild 4 — APE: Evaluierung des Schutzprofils (PP), Klassenaufbau	32
Bild 5 — ACE: Evaluierung der Schutzprofilkonfiguration, Klassenaufbau.....	43
Bild 6 — ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST), Klassenaufbau.....	60
Bild 7 — Beziehungen von ADV-Konstrukten zueinander und zu anderen Familien	77
Bild 8 — ADV: Entwicklung, Klassenaufbau	80
Bild 9 — AGD: Leitliniendokumente, Klassenaufbau	115
Bild 10 — ALC: Unterstützung des Lebenszyklus, Klassenaufbau	120
Bild 11 — ATE: Prüfungen, Klassenaufbau.....	163
Bild 12 — AVA: Anfälligkeitsbewertung, Klassenaufbau	178
Bild 13 — Beziehung zwischen ACO-Familien und Interaktionen zwischen den Komponenten.....	188
Bild 14 — Beziehung zwischen ACO-Familien.....	190
Bild 15 — ACO: Zusammensetzung, Klassenaufbau	190
Bild A.1 — Wrapper	212
Bild A.2 — Schnittstellen in einem DBMS-System	214
Bild A.3 — Teilsysteme und Module	220
Bild A.4 — Beziehung von ADV_SPM zu anderen Familien und Konstrukten	226
Bild B.1 — Abstraktion der Basiskomponente.....	231
Bild B.2 — Abstraktion der abhängigen Komponente.....	232
Bild B.3 — Abstraktion des zusammengesetzten TOEs.....	233
Bild B.4 — Schnittstellen zusammengesetzter Komponenten.....	233

Tabellen

Tabelle A.1 — Einstufung der Beschreibungsdetails	224
Tabelle C.1 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ADV: Entwicklung.....	236
Tabelle C.2 — Abhängigkeitstabelle für Klasse AGD: Leitliniendokumente.....	237

Tabelle C.3 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ALC: Unterstützung des Lebenszyklus.....	237
Tabelle C.4 — Abhängigkeitstabelle für Klasse APE: Evaluierung des Schutzprofils.....	238
Tabelle C.5 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ACE: Evaluierung der PP-Konfiguration	238
Tabelle C.6 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ASE: Evaluierung der Sicherheitsvorgabe (ST).....	239
Tabelle C.7 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ATE: Prüfungen	239
Tabelle C.8 — Abhängigkeitstabelle für Klasse AVA: Anfälligkeitsbewertung	240
Tabelle C.9 — Abhängigkeitstabelle für Klasse ACO: Zusammensetzung.....	240